CSPT 2022

主动有为，踔厉前行——共创封测产业新时代

中国半导体封装测试技术与市场年会（第二十届）

The 20th China Semiconductor Packaging and Test Technology & Market Annual Conference 2022

会议日程 Agenda

大会概览			
日 期	**时 间**	**论坛名称**	**地 点**
11 月 14 日	13:30-15:30	理事会（仅限理事参加）	一楼 102AB
	08:30-21:00	签到+展览搭建	一楼国际厅 B
11 月 15 日	09:00-18:00	高峰论坛	一楼国际厅 A
	09:00-18:00	大会展览	一楼国际厅 B
	18:00-20:30	欢迎晚宴	二楼宴会厅
11 月 16 日	09:00-16:40	专题一：封装测试工艺设备的创新和机遇	一楼 101B
	09:00-16:40	专题二：封装材料的创新与合作	一楼 102A
	09:00-11:45	专题三：先进封装和测试技术	一楼 105A
	13:30-16:40	专题四：特色工艺封装和测试技术	一楼 105A
	09:00-12:00	专题五：越亚专场论坛	一楼 106A
	13:30-17:00	专题六：国内已上市企业及投融资专场	一楼 106A
	09:00-17:00	大会展览	一楼国际厅 B

※最终议程请以实际为准，所有嘉宾参会请出示 48 小时内核酸阴性证明。

高峰论坛 Summit Forum	
时间：11 月 15 日 09:00-18:00 地点：一楼国际厅 A Time: Nov. 15th 09:00-18:00 Venue: International Hall A, 1F	
主持人：**徐冬梅** 中国半导体行业协会封测分会秘书长 Moderator：**Dongmei XU**, Secretary-General of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
时 间/Time	**内 容/Contents**
开 幕 式 Opening Ceremony	
09:00-09:40	**致欢迎辞 Welcome Speech**
	石明达 通富微电董事长、中国半导体行业协会常务理事（代表当值理事长单位） **Mingda SHI,** Rotating Chairman of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch 南通市领导 Leader From Nantong Municipal Government

	领导讲话　Leaders' Addresses
	中国半导体行业协会领导 Leader from China Semiconductor Industry Association 江苏省工信厅领导 Leader from related Department of Jiangsu Province 工业和信息化部领导
封测分会报告——Industry report	
09:40-10:00	《中国半导体封测产业现状与展望》 Current Status and Outlook of China Semiconductor Packaging and Test Industry
	石 磊，中国半导体行业协会封测分会 当值理事长 **Lei SHI**, Rotating Chairman of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch
10:00-10:10	题目待定
	南通市北高新区推介
专家报告——Plenary talk	
10:10-10:25	题目待定
	叶甜春　国家科技重大专项（02）专项专家组总体组组长 **Tianchun YE**, Chief of National Science and Technology Major Project (Project 02)
10:25-10:40	题目待定
	魏少军　国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长 **Shaojun WEI**, Chief of National Science and Technology Major Project (Project 01)
10:40-10:50	茶歇与展览交流　Networking Break
10:50-11:10	题目待定
	通富微电子股份有限公司
11:10-11:30	《新型先进封装装备进展与挑战》 Progress and Challenges of New Advanced Packaging Equipment
	张伟涛　北京北方华创微电子装备有限公司 第一刻蚀事业单元 产品总监 **Weitao ZHANG**, Beijing NAURA Microelectronics Equipment Co., Ltd. The Product Director，BU ETCH I
11:30-11:50	《小芯片 Chiplet 集成的 2.5D / 3D IC 封装技术》 2.5D & 3D IC Packaging Technology for Chiplet Integration
	李长祺　集团研发中心 处长，日月光集团 **Calvin Lee**, Director of Corporate R&D, ASE Group
11:50-12:10	《先进封装及宽禁带半导体封装材料》 Advance Package and Wide Bandgap Semiconductor Package Material

	沈 杰 半导体封装首席科学家，汉高粘合剂技术电子事业部 **Rick SHEN**, Chief Scientific Officer of Semiconductor Packaging, Adhesive Technologies – Electronics, Henkel
12:10-13:30	自助午餐 Buffet Lunch
企业报告——Keynote Speech	
主持人：**吴华** 中国半导体行业协会封测分会副秘书长 Moderator: Hua WU, Vice Secretary-General of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
13:30-13:50	题目待定
	郑 刚 长电科技汽车事业部总经理 **Gang Jung**, General Manager of JCET Automotive BU
13:50-14:10	《半导体精密磨划设备的国产化进程与展望》 Progress and prospect of semiconductor precision grinding and sawing equipment localization
	高金龙 江苏京创先进电子科技有限公司 副总经理 **Jin Long Gao**, Co-Founder,Deputy General Manager of JCA
14:10-14:30	《扇出封装的工艺基础》 Thermal Debonding: A Fundamental to Fan-Out
	宋文轩 ERS electronic GmbH 高级应用工程师 **Wenxuan Song**, ERS electronic GmbH, Senior Application Engineer
14:30-14:50	《系统级生产测试方案的应用趋势》 Trend driving the increasing adoption rate of System-Level Test
	张 宇 研发经理 | 应用开发中心 泰瑞达（上海）有限公司 **Vincent Zhang**, Application Manager | Applications Development Center, Teradyne (Shanghai) Co., Ltd
14:50-15:10	《半导体精密划片和点胶工艺分享》 Semiconductor precision dicing and dispensing process sharing
	周 云 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 精密切割事业部总监 **Zhou yun**, Director of Precision Dicing Business Department, Shenzhen Tensun Precision Equipment Co., Ltd
15:10-15:30	茶歇与交流 Networking Break
15:30-15:50	《后摩尔时代晶圆级先进封装的机遇和挑战》 Opportunities and Challenges to advanced wafer level packaging in post-Moore era
	马书英 华天科技(昆山)电子有限公司 研究院院长 **Dennies Ma**, President of Research Institute, Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd
15:50-16:10	《Chiplet 技术与设计挑战》 Chiplet Technology and Design Challenges

	代文亮 芯和半导体联合创始人 **Wenliang DAI**, Co-Founder of Xpeedic Co. Ltd.
16:10-16:30	《复合机器人助力封测车间物流自动化》 Logistics automation of semiconductor back-end factory assisted by Autonomous Mobile Robot
	黄建龙 深圳优艾智合机器人有限公司 半导体自动化事业部 总经理 **Kent Huang**, Semiconductor AMHS BU General Manager of Shenzhen Youibot Robotics Co.,Ltd.
16:30-16:50	《基于扇出型工艺的差异化封装》 Differentiated packaging based on fan-out process
	谭小春 合肥矽迈微电子科技有限公司 总经理 **Xiaochun TAN**, GM of smatmicrotech
16:50-17:10	《高精度视觉与深度学习赋能半导体封测创新》 High precision vision and deep learning enable semiconductor seal test innovation
	郑军 聚时科技（上海）有限公司 创始人及 CEO **Jun Zheng**, CEO&Founder of Matrixtime Robotics Co., Ltd
17:10-17:30	《赋能中国芯--华封科技先进封装解决方案》 Capcon's Advanced Packaging Solutions Reinforce China's Chip Power
	宋 涛 华封科技副总裁 **Jason Song**, Vice President of Capcon Limited
17:30-17:50	《以太网芯片测试挑战与解决方案》 Ethernet chip testing Challenges and solutions
	张凯虹 中科芯集成电路有限公司检测中心，无锡中微腾芯电子有限公司总经理 **Kaihong Zhang**, China Key System & Integrated Circuit Co., Ltd., GM of CMC electronics CO., LTD
18:00-20:00	欢迎晚宴 Welcome Dinner 二楼宴会厅 Ballroom, 2F

专题一：封装测试工艺设备的创新和机遇 **Session I: Innovation and Opportunities of Semiconductor Packaging & Test Equipment**	
时间：11 月 16 日 09:00-16:10 地点：一楼 101B Time: Nov. 16th 09:00-16:10 Venue: Room 101B, 1F	
时 间/Time	**内 容/Contents**
主持人：**刘卫东** 中国半导体行业协会封测分会副秘书长 Moderator: **Weidong LIU**, Vice Secretary-General of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
09:00-09:25	《多物理场仿真技术在系统级封装设计中的应用》 Multiphysics Simulation in Application to System-in-Package Design
	周立彦 中科芯集成电路有限公司、无锡中微高科电子有限公司 资深仿真工程师

	Liyan Zhou, Simulation Engineer, China Key System & Integrated Circuit Co., Ltd., Wuxi Zhongwei HIGH-TECH Eletronics Co., Ltd.
09:25-09:50	题目待定 TBD
	贺云波 广东阿达智能装备有限公司 董事长 **HE YUNBO**, Chairman of Guangdong Ada Intelligent Equipment Ltd.
09:50-10:15	《后摩尔时代的封装技术，国产固晶设备的机遇与挑战》 Packaging Technology of Post Moore Era, Opportunities and Challenges of Domestic Die Attach
	孟晋辉 东莞普莱信智能技术有限公司 总经理 **Meng JingHui**, Dongguan Precision Intelligent Technology Co., LTD, General Manager
10:15-10:30	茶歇与交流 Networking Break
10:30-10:55	《SiP 微组装设备若干工程挑战》 Engineering challenges for SiP Micro-assembly Equipments
	王 敕 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 董事长/创始人 **Eric，Chi WANG**, Founder/Board Chairman of SUZHOU ACCURACY ASSEMBLY AUTOMATION Co., Ltd
10:55-11:20	先进封装的新兴工艺和组装挑战 Emerging Process and Assembly Challenges in Advanced Semiconductor Packaging
	代翔宇 环球仪器 中国区产品市场经理 **Xiangyu DAI**, Product Marketing Manager – China, Universal Instruments Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd
11:20-11:45	《用于先进 SiC 功率模块的整体解决（核心设备/材料/工程）方案》 The Overall Solution (Core Equipment/Materials/Engineering) for Advanced SiC Power Modules
	周 鑫 苏州博湃半导体科技有限公司 市场销售总监 **Xin Zhou**，Suzhou Bopai Semiconductor Technology Co., Ltd Marketing & Sales Director
11:45-12:10	《先进封装制程发展&压膜及气泡解决方案》 Advanced packaging process development & Compression film and bubble solutions
	张景南 南京屹立芯创半导体科技有限公司总经理 **Woody Jones**, General Manager of Elead Tech
12:10-13:30	自助午餐 Buffet Lunch
13:30-13:55	《W2W 和 D2W 混合键合技术的挑战和解决方案》 Challenges and solution of W2W and D2W hybrid bonding
	蔡维伽 中国苏斯微技术 键合产品及应用专家 **Max Cai**, Bonder Product & Application Specialist, SUSS MicroTec (Shanghai)Co., Ltd
13:55-14:20	《静电和微尘的智能管控，提高半导体制程良率》 Intelligent control of static electricity and fine dust to improve the yield of semiconductor manufacturing process
	邹光杰 苏州凯仕德科技有限公司执行总监、凯仕德集团股东 **Linda.Zou**, CEO of SuZhou KESD technology co.,ltd, Shareholder of KESD

14:20-14:45	《复合机器人助力半导体企业实现智慧生产》 Composite robots enable semiconductor companies realize smart production
	林嘉伟 亿嘉和科技股份有限公司智慧工厂事业部市场营销总监 **Jiawei LIN**, Marketing Director of Smart Factory Business Unit, YIJIAHE Technology Co., Ltd.
14:45-15:10	《湿法封装制程设备挑战和进展》 Challenges and Progress of Wet Packaging Equipment
	仰 庶 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 工艺部高级经理 **Shu Yang**, Senior Process Manager of ACM Research (Shanghai), Inc.
15:10-15:25	茶歇与展览交流 Networking
15:25-15:50	《SEC-半导体封装检测应用》 SSEC-Semiconductor Testing Technology Application
	李峰云 上海赛可检测设备有限公司销售经理 **LiFengYun**, Sales Manager of SHANGHAI SEC INSPECTION EQUIPMENT Co., Ltd.
15:50-16:15	《高产能飞秒激光诱导刻蚀玻璃通孔技术及应用》 High throughput femtosecond laser induced etching of glass (TGV) technology and its Applications
	卢建刚 大族半导体脆性材料加工项目中心负责人 **Jianggang LU**, R&D Director, HSET, Laser Brittle Materials Processing
16:15-16:40	《新一代电子系统互联和封装技术的进展》 Advances in Interconnect and Assembly Technologies for Next Generation Electronic Systems
	李 彬 Besi 中国区总经理 **Bin LI**, Director of Besi China
结束-END	

专题二：封装材料的创新与合作 **Session II: Innovation and Cooperation of Advanced packaging Materials**	
时间：11 月 16 日 09:00-16:35 地点：一楼 102A Time: Nov. 16th 09:00-16:35 Venue: Room 102A, 1F	
时 间/Time	**内 容/Contents**
主持人：张国华 中国半导体行业协会封测分会副秘书长 Moderator: **Guohua ZHANG**, Vice Secretary-General of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
09:00-09:25	《高端封装用 EMC 解决方案》 EMC solutions for High-end packaging
	蔡晓东 衡所华威电子有限公司 研发中心总监 **Xiaodong Cai**, R&D Center Director of Hysol Huawei
09:25-09:50	《高温无铅芯片贴装材料的创新和应用》

	New HTPBF Material for Die Attached Application in Power Semiconductors
	胡彦杰 铟泰公司 华东区高级技术经理 **Leo Hu,** Sr. Technical Manager- East China, Indium Corporation
09:50-10:15	《汽车电子用高可靠性封装解决方案》 High reliable packaging solution for Automotive application
	张 靖 博士 贺利氏电子 中国区研发总监 **Dr. Jing Zhang**, Head of Shanghai Innovation Center, Heraeus Electroncis China
10:15-10:30	茶歇与展览交流 Networking Break
10:30-10:55	《科化环氧塑封料产品研究进展》 Research Progress of Epoxy Molding Compound in KEHUA
	王善学 江苏科化新材料科技有限公司 副总经理 **Shanxue Wang**, Dupty Gerneral Manager, Jiangsu KEHUA New Materials Technology Co., Ltd
10:55-11:20	《帝科湃泰助力半导体电子粘合剂国产化》 DKEM PacTite Advancing the Localization of Semiconductor Electronic Adhesives
	张 犇 帝科股份无锡湃泰电子材料科技有限公司市场及销售总监 **Ben Zhang**, Director of Marketing & Sales of DKEM Wuxi Pactite Electronic Materials Technology Co., Ltd
11:20-11:45	《高品质半导体引线框架铜合金》 High Quality Lead Frame Copper Alloy
	杨泰胜 博威合金板带 技术市场部行业经理 Tyson, Industry Manager, boway alloy Strip Technology Marketing Department
12:00-13:30	自助午餐 Lunch
13:30-13:55	《新阶段封装材料的挑战------韦尔通科技封装产品介绍》 The Challenge and Solution for Advanced Package Material
	张建东 韦尔通科技股份有限公司技术经理 **Tommy Zhang**, Weldtone Technology Co. Ltd
13:55-14:20	《先进封装用环氧塑封料解决方案》 Reliable Solution of Epoxy Mold Compound for Advanced Package
	陆海平 上海道宜半导体材料有限公司 研发总监 **Roger Lu**, R&D Director of DOITECH Semiconductor Advanced Materials. Co.Ltd
14:20-14:45	《先进封装清洗工艺及工艺监控》 Advanced Packaging Cleaning Process and Process Control
	李肖晨 ZESTRON 北亚区 应用技术工程师 **Kevin Lee**, Technical Technology Engineer, ZESTRON North Asia
14:45-15:10	《汽车电子对环氧塑封料的要求》 Automotive Electronics and its requirements on EMC
	谭 伟 江苏华海诚科新材料股份有限公司 研发经理 **Wei Tan**, Jiangsu HHCK Advanced Materials Co., Ltd.
15:10-15:25	茶歇与展览交流 Networking Break
15:25-15:50	《先进封装材料 CUF 及 LMC 解决方案》

	Solutions of advanced packaging materials CUF and LMC
	王明海 上海本诺电子材料 CTO **Minghai Wang**, CTO of Bonotec Electronic Materials
15:50-16:15	《先进封装高可靠性国产化焊料的研究及应用》 Research and application of advanced packaging domestic solder material with high reliability
	习浩亮 上海华庆焊材技术股份有限公司 市场总监 Harry Xi, Shanghai Huaqing Solder M&T Co., Marketing Director
16:15-16:40	《复杂国际环境下中国 Memory 封测的挑战与应对》 Challenges and responses to Chinese memory packaging and testing industry in a complex international environment
	周健威 华天科技（南京）有限公司 Memory 事业部总经理 Memory 研发总监 **Jianwei Zhou**, Memory R&D Director of Huatian Technology Nanjing Co. Ltd, Head of Memory BU
结束——END	

专题三：先进封装和测试技术 **Session III: Advanced Packaging & Test Technology**	
时间：11 月 16 日 09:00-11:45 地点：一楼 105A Time: Nov. 16th 09:00-11:45 Venue: Room 105A, 1F	
时 间/Time	**内 容/Contents**
主持人：任霞 中国半导体行业协会封测分会副秘书长 Moderator: **Xia REN**, Vice Secretary-general of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
09:00-09:25	题目待定
	郭宇铮 武汉大学动力与机械学院 Yuzheng GUO, Wuhan University
09:25-09:50	《摩尔定律背后的推力》 PI Solutions to Move Mo(o)re
	Cliff Huang PI 半导体事业部市场总监 **Cliff Huang**, Head of Segment Marketing at Physik Instrumente
09:50-10:15	《先进封装基板技术》 Substrate Technology under Advanced Packaging
	李 俊 深南电路股份有限公司 技术专家 **Jun LI,** R&D Specialist of Shennan Circuits CO., LTD
10:15-10:30	茶歇与展览交流 Tea break
10:30-10:55	《蔡司显微镜先进封装失效分析解决方案》

	ZEISS Microscopy Solutions for advanced semiconductor packaging failure analysis
	黄承梁 卡尔蔡司（上海）管理有限公司业务拓展经理 **Chengliang Huang**, BD Manager of Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd
10:55-11:20	《工业元宇宙技术在集成电路封测行业的应用研究》 Primary Exploration on IC packaging and testing industry of Industrial Metaverse
	王其高 南京品微智能科技有限公司产品与咨询副总 **Michael Wang**, Vice General Manager of Product & Consulting
11:20-11:45	《赛默飞世尔科技在先进封装中的解决方案》 Thermo Fisher Scientific Solutions for Advanced Packaging
	高保林 赛默飞中国区半导体事业部资深应用经理、电性失效分析业务拓展经理 **Smith Gao**, Sr Manager, Thermo Fisher China Semi Apps, EFA sales development
12:00-13:30	自助午餐 Buffet Lunch
专题四：特色工艺封装和测试技术 **Session IV: Specialty Packaging & Test Technology**	
时间：11 月 16 日 13:30-17:00 地点：一楼 105A Time: Nov. 16th 13:30-17:00 Venue: Room 105A, 1F	
主持人：任 霞 中国半导体行业协会封测分会副秘书长 Moderator: **Xia REN**, Vice Secretary-general of China Semiconductor Industry Association, Packaging & Test Branch	
13:30-13:55	《碳化硅器件动态特性测试技术剖析》 Silicon Carbide Devices Dynamic Characteristics Testing Technology Analysis
	高 远 泰科天润应用测试中心主任 **Yuan Gao**, Director of Application Test Center at Global Power Technology Co., Ltd.
13:55-14:20	《功率半导体特色封装与先进封装工艺》 Characteristic Packaging and Advanced Packaging Process of Power Semiconductor
	吴建忠 华润微电子有限公司封装事业群总经理 **Jianzhong WU**, General Manager of Assembly & Test Business Group, China Resources Microelectronics Limited
14:20-14:45	《特色工艺封装测试技术》 Feature packaging processes and testing technology
	姜 峰 厦门云天半导体科技有限公司高级总监 **Feng Jiang**, Senior Director of Sky Semi.
14:45-15:10	《ASMPT 对于功率半导体银烧结工艺的整体解决方案》 ASMPT AgS Total Solution
	凌晓渊 ASMPT 市场营销经理、ASMPT 半导体解决方案事业部 **Brian Ling**, ASMPT Marketing Manager, ASMPT Semiconductor Solutions, ASMPT SEMI China Ltd.
15:10-15:25	茶歇与展览交流 Networking Break
15:25-15:50	《碳化硅功率模块封装工艺技术探讨》

	Discussion on Package & Process Technology of SiC Power Module
	孙炎权 基本半导体技术总监 **Jet Sun**, Director, BASIC Semiconductor
15:50-16:15	《先进封装在光电集成中的应用》 Applying the Advanced Packaging Technology in Optoelectronic Hybrid Integration
	刘丰满 华进半导体首席科学家 **Fengman LIU**, Chief Scientist of NCAP China
16:15-16:40	题目待定
	通富微电子股份有限公司
结束——END	

专题五：越亚专场论坛 Session V: ACCESS Forum	
时间：11 月 16 日 09:00-12:00 地点：一楼 106A	
09:00-09:25	《射频前端模组对封装基板的挑战与应对》
	林红宽 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 高级工程经理
09:30-09:55	《5G 先进滤波器与射频前端模组的机遇与挑战》
	贾 斌 开元通信技术（厦门）有限公司 CEO
10:00-10:25	《ISM6636X-业界体积最小的 6A 直流降压电源模块》
	王 卿 东莞长工微电子有限公司 高级销售经理
10:30-10:55	《后摩尔时代封装创新趋势分析》
	通富微电子股份有限公司
11:00-11:25	《芯德先进封装和嵌入式解决方案》
	张 中 江苏芯德半导体科技有限公司 副总经理
11:30-11:50	《高 Q 值埋磁集成电感封装载板助力 SiP 先进封装》
	黄本霞 珠海越亚半导体股份有限公司 产品平台研发部总监
12:00-13:30	午餐 Lunch
专题六：已上市企业及投融资专场	
时间：11 月 16 日 13:30-17:00 地点：一楼 106A **主持人：吴华** 中国半导体行业协会封测分会副秘书长	
13:30-17:00	
结束——END	

备注：最终议程以实际为准。

·**会务组联系电话** 施玥如 13661508648（微信同号）

CSPT 2022

主动有为，踔厉前行——共创封测产业新时代

关注会议